後工程の役割を、図や映像で学ぶ

半導体

九州大学

大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門

師

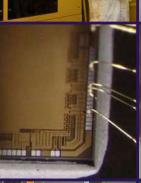
准教授木野久志氏

後工程

の基礎















お申し込み期間は2025年10月30日(木)9:00から2026年1月21日(水)17:00までとなります。

受講料 初回特別提供 3.300円(税込)

------定員:対面受講30名/オンライン90名



●対面受講会場

福岡システムLSI総合開発センター 2F 講義室

住所 福岡市早良区百道浜3-8-33 TEL 092-822-1550



●お申込み方法

ふくおかISTe-learningのホームページより、「講座・セミナー 等 申込」をクリックし、「半導体後工程の基礎」の「対面受講 申込」または「オンライン(OL)受講申込」を選択ください。

ふくおかISTe-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail: reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 福岡半導体リスキリングセンター 事務局

- お申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です。 お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。
- 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。■ 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。
- 会場にて全受講者に紙テキストを配布します。PDFテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)のダウンロードも可能です。※テキストの無断転載・複製等は禁止しています。
- 演習に使用するPC・MATLABライセンスは会場にて準備しております。



公益財団法人 福岡県産業·科学技術振興財団

半導体製品が完成するまでの「後工程」について、前工程との違いから検査・梱包・ 出荷までの流れをやさしく解説します。工程の役割を図や映像で学ぶことで 各工程の意味やパッケージの多様性が理解できます。先端パッケージ動向にも 触れる、後工程理解の入門講座です。半導体業界の新入社員・若手技術者は元より 後工程を把握したい初学者におすすめする講座です。

第1章 はじめに

- 1. 半導体の後工程って?
- 2. 前工程・後工程(ダイソート工程から梱包まで)
- 3. 何で、後工程が必要なの?
- 4. パッケージって何種類くらいあるの?
- 5. 用途に応じたパッケージの選び方

第2章 後工程全体の流れ

全体を俯瞰できる形での製造プロセスの流れ

※講座内容は一部変更になる場合がございます。

第3章 後工程プロセス全体(実際の工程のビデオ映像で現場感を掴みます)

撮影協力:株式会社 デンケン

1.ダイソート

2. 表面テープの貼りつけ

3. バックサイドグラインド

4. 保護テープ剥離

5. 裏面チッピング防止シート貼り

6.Dicing

7. チップピックアップ(良品だけ)

8. フレームについての説明

9. ペースト塗布

10. ダイマウント

11. ベーキング処理

12. ワイヤーボンディング

13. モールド

14. ボール搭載

15. 後 Dicing

16. ファイナルテスト (NG 品選別)

17. レーザーマーク

18. 検査・出荷準備・梱包

第4章 後工程パッケージの最新動向

- 1. なぜ後工程に注目が集まる?
- 2. 2.5/3D パッケージとは?
- 3. 微細再配線工程
- 4. Nvidia の目指すところ



クリーンルームに入室し、研究開発用設備の見学や サンプルの観察・測定を体験していただけます。

会場: 福岡超集積半導体ソリューションセンター

■応募詳細につきましては受講申込済の方に別途ご案内いたします。



お申込みの前に福岡半導体

